リョーサン菱洋
RYOYO RYOSAN

Press Release

2026 年 11 月 12 日

各位

リョーサン菱洋株式会社
リョーサン菱洋ホールディングス株式会社
（東証プライム 167A）

リョーサン菱洋、台湾の世界有数の半導体メーカー MediaTek と代理店契約を締結

フィジカル AI 活用が進む車載･産機分野への用途に応じた提案を通じ、国内製造業の競争力向上に貢献

リョーサン菱洋ホールディングス株式会社の事業会社である、エレクトロニクス商社のリョーサン菱洋株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：稲葉 和彦、以下「リョーサン菱洋」）は、台湾に本社を置き、**売上高世界第 5 位[*1]のファブレス半導体メーカー**として、SoC（System-on-Chip）をはじめとする半導体製品の設計・開発を手がける **MediaTek Inc.**（本社：台湾新竹市、以下「MediaTek」）**と代理店契約を締結**しました。

スマートフォン向け SoC の分野で高い実績を持つ MediaTek は、**リョーサン菱洋の顧客基盤である自動車や産業機器分野**においても高い可能性を有しており、リョーサン菱洋は**両分野における市場展開を推進**していきます。

■ 背景

近年、AI を活用した次世代車の開発が加速するとともに、ロボットや産業機器などが AI によって自律的に判断・実行する「**フィジカル AI**」が次の成長領域として注目を集めています。その実現を支える技術として、**エッジ AI の重要性**も高まっています。日本でも AI やロボティクスの活用による産業競争力の強化が重要な政策課題となっており、**製造業を中心に関連技術への投資が拡大**しています。

こうした中、MediaTek はスマートフォン向け SoC で培った高い処理性能や通信技術を活かし、自動車分野をはじめ、ロボット、IoT 機器など**エッジ AI が求められる分野への展開を進めています。**

リョーサン菱洋は、特に旧リョーサンの事業で培ってきた MCU（マイコン）やメモリの販売を通じた**車載部品メーカーとの強固な顧客基盤**に加え、SoC や通信デバイスの活用が進む**民生機器メーカー**や **IoT・産業機器メーカー**との接点を有しています。さらに、デバイス提供にとどまらず、大規模な AI インフラ導入から**エッジ AI システムの実装**まで幅広い支援を通じて、お客様の製品開発を研究開発段階から支援しています。

[*1] 出典：TrendForce「2025 年 世界ファブレス IC 設計企業 売上高ランキング」（2026 年 4 月 1 日）

両社はそれぞれの強みを活かし、フィジカル AI やエッジ AI の活用が進む国内製造業に対して、MediaTek の先進的な技術の提供を推進し、**日本市場における次世代モビリティおよびインテリジェントデバイス市場の創出**に貢献してまいります。

■　独自のサポート

リョーサン菱洋は、このたびの取り扱い開始に伴い、**専任の FAE（フィールドアプリケーションエンジニア）および営業体制を整備**し、お客様の研究開発から、設計、量産までをサポートします。

また、旧菱洋エレクトロのソリューション事業で培ってきた、**エンベデッドボードメーカー*2との豊富な取引実績**を活かし、**MediaTek の SoC を搭載したカスタムボードの提案にも対応**します。お客様ごとの製品仕様や、用途に応じた最適なソリューションを提供することで、お客様の製品競争力の向上と開発負荷の低減に貢献してまいります。

■両社のコメント

メディアテックジャパン　アカウントマネジメント ディレクター 増田嘉幸氏のコメント
長年に渡って培った強固な顧客基盤と、半導体に加え各種ソリューションビジネスまで幅広い領域で強みを持つリョーサン菱洋との協業は、大きな可能性を秘めていると感じています。
双方の知見やネットワークを活かし、新たなビジネス機会の創出と事業の成長につなげていきたいと考えています。

リョーサン菱洋　取締役執行役員 ソリューション営業本部長 青木良行のコメント
今回の代理店契約は、単に新たな半導体製品を取り扱うだけでなく、AI をはじめとする技術の進化により、様々な領域で製品の高度化や競争力向上が求められる時代を見据え、当社がお客様の製品開発をより強力に支援していくための重要な取り組みです。
MediaTek の先進的な半導体と、当社が培ってきた車載・産業機器分野の顧客基盤、AI や組み込み分野の技術力を組み合わせ、お客様の新たな製品や事業の創出につなげてまいります。
今後も MediaTek とともに、お客様の新たな挑戦を支え、日本の製造業のさらなる発展に貢献してまいります。

■　MediaTek について

MediaTek（台湾証券取引所：2454）は、ファブレス半導体設計分野における世界的なリーダーであり、エッジからクラウドまで幅広いソリューションを提供しています。
毎年 20 億台を超えるコネクテッドデバイスに採用されている同社の先進技術は、世界をつなぎ、人々

*2 SoC や CPU などを搭載し、お客様が製品開発に活用できる基板（ボード）を設計・開発するメーカー。

の日常をより豊かにしています。MediaTek は、AI、5G/6G、Wi-Fi 7/Wi-Fi 8 といった変革的テクノロジーの最前線に立ち、イノベーションを牽引しています。
高性能かつ省電力な製品群は、よりスマートにつながる世界の基盤となり、スマートフォン、スマートホーム、AI PC から、ハイパフォーマンス・コンピューティング、車載、AI データセンターに至るまで、さまざまなデバイスを支えています。
世界をリードするブランドから信頼されるパートナーとして、MediaTek は、グローバル社会の進化するニーズに応えるソリューションを生み出し、世界最高水準のテクノロジーをすべての人が利用できる環境を実現しています。
また MediaTek は、AI の発展を加速させる取り組みを通じて、人類の未来をより豊かにすることを目指しています。

■　リョーサン菱洋について

　リョーサン菱洋は、半導体、AI、IT、産業 DX などの領域で、単なる製品の販売にとどまらず、お客様の事業成長のための支援を提供するエレクトロニクス商社です。2026 年 4 月 1 日に、リョーサンと菱洋エレクトロの統合により、両社の強みを結集し、新たなスタートを切りました。
　『お客様のニーズにお応えし 社会に必要とされる企業になる』をビジョンに掲げ、目の前のお客様はもちろん、その先にいるエンドユーザー様までを「お客様」と捉えています。リョーサン菱洋は、お客様の課題解決を通じて、IT 産業のさらなる発展に寄与し、社会への貢献を目指します。

社　　名 ： リョーサン菱洋株式会社
代　　表 ： 代表取締役社長執行役員　稲葉 和彦
事 業 内 容： 半導体や電子部品の販売および製造
　　IT 機器や付随するシステムの販売、製造および構築
設 立 日 ： 1953 年 11 月
資 本 金 ： 17,690 百万円
U　R　L ： ▶リョーサン菱洋オフィシャルサイト



本件に関するお問い合わせ

リョーサン菱洋ホールディングス株式会社　企画本部 広報部
TEL：03-3546-6331　Email：pr@rers-grp.com